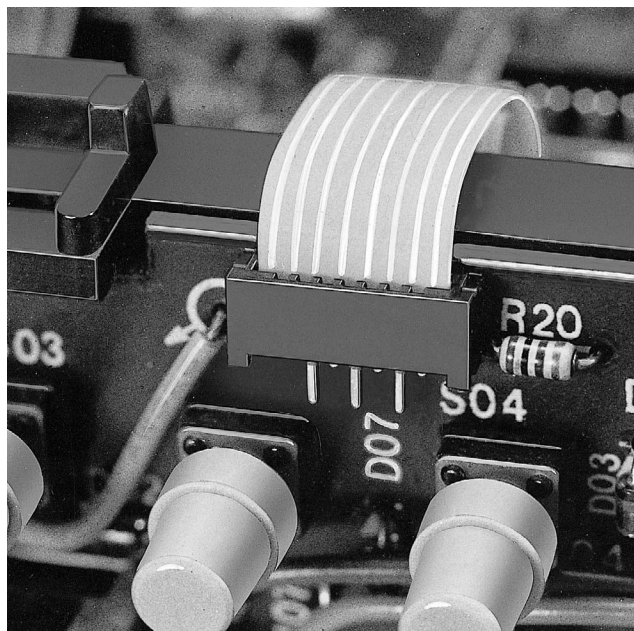
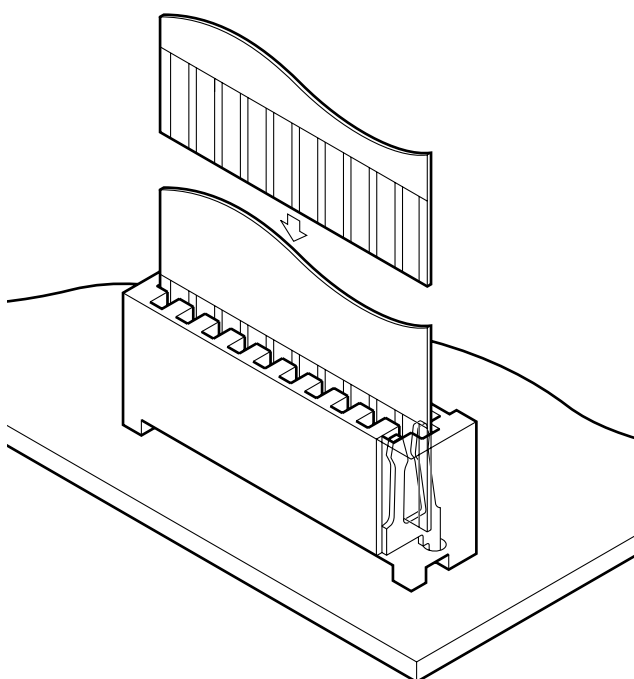




FMコネクタは、リードピッチ1.0mmのFFC・FPC接続に対応した基板用コネクタです。高密度実装機器内、メカニカルユニット間の接続など、機器の振動、衝撃に対しても安定した接触構造で高い信頼性を持っています。FFC・FPCとの接続も簡単なスナップイン装着。厚さ3.0mmの小型化を実現しました。ディップタイプとともに耐熱樹脂を使用した表面実装(SMT)タイプもあります。



■特長

●厚さ3.0mmのコンパクト設計

ピッチ1.0mmで、複雑なカム機構やスライド機構を省き、しかも信頼の高い接続を実現。実装高さ4.4mm、厚さ3.0mm小型設計です。

●両面接触による高信頼設計

コンタクトは、ばね性に優れたりん青銅を使用した高接触圧の両面接触構造で、FFC・FPCとの確実な接続が得られます。また両面接触構造のため、リード部の導体面に対する配慮を必要とせずコネクタにFFC・FPCを接続できますので、実装設計が容易です。

●接続が簡単なスナップイン方式

FFC・FPCリードをコネクタに挿入するだけの簡単な作業で、ケーブルの接続と保持ができるスナップイン方式。

●表面実装(SMT)タイプ

電子機器内部素子のSMT化に対応し、ハウジングに耐熱性に優れた樹脂を採用した、リフローはんだ対応の表面実装タイプも用意しています。実装設計のより高密度化が可能となります。

■登録規格

UL: Recognized E 60389

CS: Certified LR 20812

■一般仕様

- 定格電流：0.5A AC・DC
- 定格電圧：50V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／20mΩ以下
環境試験後／30mΩ以下
- 絶縁抵抗：800MΩ以上
- 耐電圧：AC 500V・1分間
- 適用FFC・FPC：導体ピッチ／1.0mm
導体幅／0.7mm
接触部厚さ／0.33^{+0.02}_{-0.03}mm

- 適合プリント基板厚さ：0.8mm～1.6mm

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

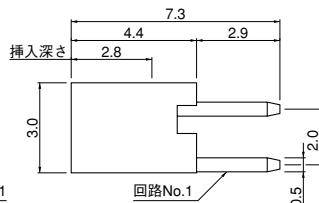
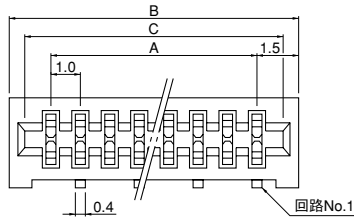
※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。

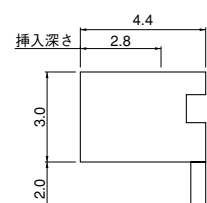
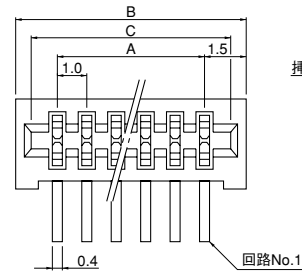
コネクタ

トップ型

●ディップタイプ

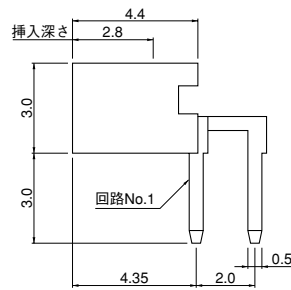
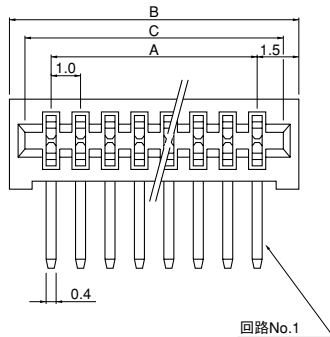


●表面実装タイプ

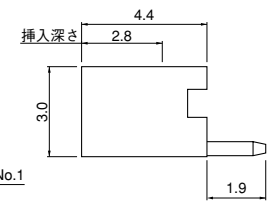
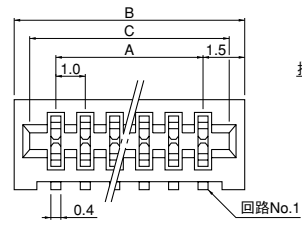


サイド型

●ディップタイプ



●表面実装タイプ



ディップタイプ

極 数	形 番		寸法 (mm)			個数/箱
	トップ型	サイド型	A	B	C	
3	03FM-1.0BT	03FM-1.0ST	2.0	5.0	4.1	2,000
4	04FM-1.0BT	04FM-1.0ST	3.0	6.0	5.1	2,000
5	05FM-1.0BT	05FM-1.0ST	4.0	7.0	6.1	2,000
6	06FM-1.0BT	06FM-1.0ST	5.0	8.0	7.1	1,000
7	07FM-1.0BT	07FM-1.0ST	6.0	9.0	8.1	1,000
8	08FM-1.0BT	08FM-1.0ST	7.0	10.0	9.1	1,000
10	10FM-1.0BT	10FM-1.0ST	9.0	12.0	11.1	1,000
11	11FM-1.0BT	11FM-1.0ST	10.0	13.0	12.1	1,000
12	12FM-1.0BT	12FM-1.0ST	11.0	14.0	13.1	1,000

表面実装タイプ (エンボステーピング品)

極 数	形 番		寸法 (mm)			個数/リール	
	トップ型	サイド型	A	B	C	トップ型	サイド型
3	—	03FM-1.0SP-1.9-TF	2.0	5.0	4.1	—	2,500
4	04FM-1.0BP-TF	04FM-1.0SP-1.9-TF	3.0	6.0	5.1	1,000	2,500
5	05FM-1.0BP-TF	05FM-1.0SP-1.9-TF	4.0	7.0	6.1	1,000	2,500
6	06FM-1.0BP-TF	06FM-1.0SP-1.9-TF	5.0	8.0	7.1	1,000	2,500
7	07FM-1.0BP-TF	07FM-1.0SP-1.9-TF	6.0	9.0	8.1	1,000	2,500
8	08FM-1.0BP-TF	08FM-1.0SP-1.9-TF	7.0	10.0	9.1	1,000	2,500
10	10FM-1.0BP-TF-A	10FM-1.0SP-1.9-TF	9.0	12.0	11.1	1,000	2,000
12	—	12FM-1.0SP-1.9-TF	11.0	14.0	13.1	—	2,000

材 質・表面処理

ディップタイプ/コンタクト: リン青銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ハウジング: PBT・UL94V-0

表面実装タイプ/コンタクト: リン青銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

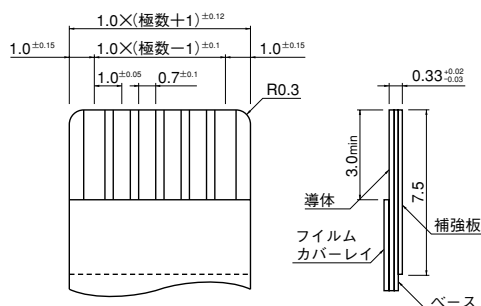
ハウジング: PPS・UL94V-0

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

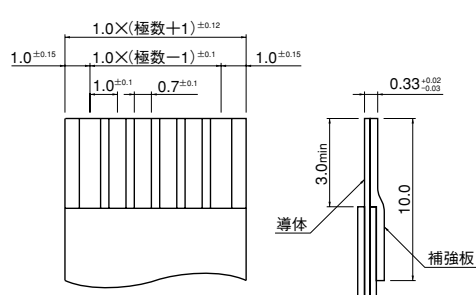
FM CONNECTOR

FFC・FPCリード部寸法

FPC



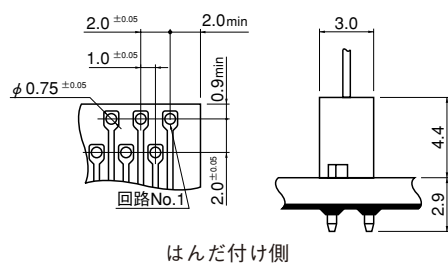
FFC



基板レイアウト・組立レイアウト

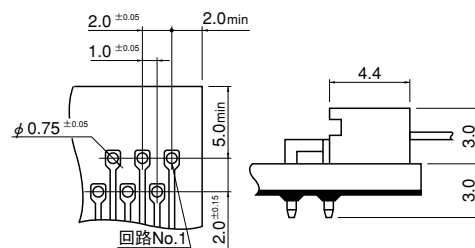
●ディップタイプ

トップ型



はんだ付け側

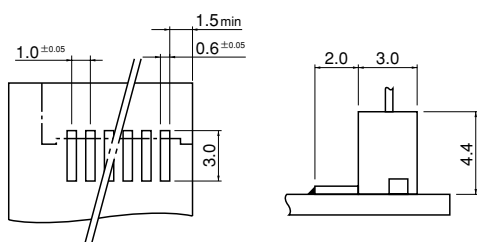
サイド型



はんだ付け側

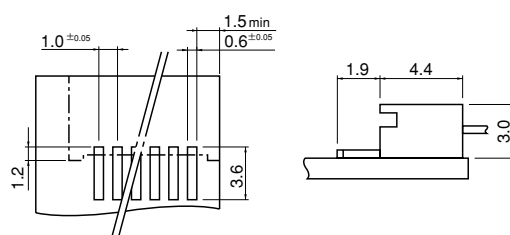
●表面実装タイプ

トップ型



コネクタ装着側

サイド型



コネクタ装着側

- 注1) 基板の穴あけ、パターンピッチは全体にわたって公差 ± 0.05 で累積しないこと。
 2) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。
 3) 表面実装タイプの使用につきましては、熱硬化性樹脂等での固定をお勧めします。詳しくは弊社までお問い合わせください。